



Бросая вызов стереотипам

Дмитрий Ерошенко
Региональный
представитель

КТО МЫ ?



Год основания – 2014.

Ведущая российская технологическая компания, разработчик и производитель вычислительных систем, систем хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, лидер российского рынка вычислительной техники.

YADRO объединяет весь цикл программной и аппаратной разработки, производства, тестирования и обслуживания собственных продуктов, линейки которых постоянно расширяются.

Команда YADRO — это талантливые инженеры и эксперты в самых разных направлениях, с многолетним опытом и профессиональными знаниями.

1 место

41% в емкостном выражении.

Доля компании YADRO на российском рынке систем хранения данных.

2 место

16% в денежном выражении.

Доля компании YADRO на российском рынке систем хранения данных.

2 место

17% в денежном выражении.

Доля компании YADRO на российском рынке серверов.

По данным IDC Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker по итогам 2021 года

Что мы продаем ?

VEGMAN

Отечественные серверы стандартной архитектуры.

R120 G1

Новый представитель линейки отечественных серверов, предназначенный для обслуживания широкого спектра корпоративных приложений и повышения скорости обработки современных задач.

S220, S320

Масштабируемые серверы для задач, которые требуют экономичного хранения больших объёмов данных.



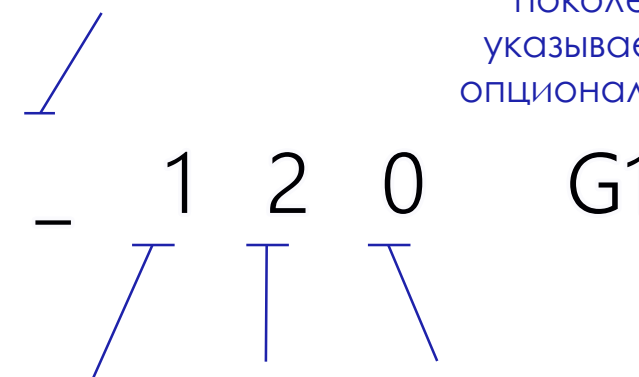
Тип сервера

R — Robust

S — Storage

Поколение

Для первого поколения указывается опционально



Высота в шкафу (U)

Количество сокетов

Платформа
0 — Intel

	VEGMAN S220	VEGMAN S320	VEGMAN R120 G1
Размер корпуса	2U 19"	3U 19"	1U 19"
Вычислительные мощности	1 или 2 процессора Intel Xeon Scalable v2, TDP до 205 Вт		
Характеристика дисковых подсистем	Гибридная подсистема хранения с сочетанием накопителей SAS/SATA/NVMe		
Оперативная память	До 3 ТБ, 1 DPC		До 6 ТБ, 2 DPC
Количество отсеков для основных накопителей	16 × SAS/SATA LFF спереди	32 × SAS/SATA LFF спереди	Варианты конфигураций: 4 × LFF SAS/SATA HDD/SSD 10 × SFF SAS/SATA/NVMe
Максимальная ёмкость и плотность основной системы хранения (диски 16 ТБ)	256 ТБ 128 ТБ/У	512 ТБ 170,6 ТБ/У	64 ТБ 64 ТБ/У
Дополнительная система хранения	4 × SATA PCH RAID или NVMe SFF		2 × SFF SAS/SATA/NVMe-U.2 сзади опционально вместо 2 отсеков для PCIe
Накопители для загрузки ОС	2 × M.2 SATA SSD установка на системную плату (SW RAID) или опциональный RAID-контроллер для M.2		2 × M.2 SATA SSD установка на системную плату, только SW RAID
Количество разъёмов PCIe	До 7 шт.	До 9 шт.	До 3 шт.
Количество поддерживаемых карт расширения*	Один GPU двойной ширины или два GPU одинарной ширины	Два GPU двойной ширины или два GPU одинарной ширины	До одного GPU одинарной ширины
Потребляемая мощность	До 1600 Вт	До 2000 Вт	До 1600 Вт

СДЕЛАНО В РОССИИ



Сертификация МПТ

VEGMAN
R120 / S220/S320

НАХОДЯТСЯ В

[Реестре МПТ 719ПП](#)

и [Реестре МПТ 878ПП](#)



Разработано инженерами YADRO

Собственные печатные платы, механические компоненты, firmware



Локальная сборка и автоматизированное тестирование



Полная локальная поддержка

Вся техническая экспертиза и документация внутри страны,

сотрудники поддержки имеют прямой доступ к разработчикам и говорят на русском языке

Владение интеллектуальной собственностью

Конструкторская и технологическая документация на платформу, исходные коды firmware





ПОДДЕРЖКА ОС И ГИПЕРВИЗОРОВ



Сертифицировано



Сертифицировано



Сертифицировано



Запланировано



Запланировано



Запланировано



Совместимо *



Совместимо *



Red Hat

Совместимо *



Совместимо *



Совместимо *

TATLIN.UNIFIED — надежная система хранения данных класса midrange уровня enterprise нового поколения для решения разноплановых задач с исключительными показателями плотности и стоимости владения.



Базы данных



Аналитика



Виртуализация



Стриминг

КОНТРОЛЛЕРНОЕ ШАССИ



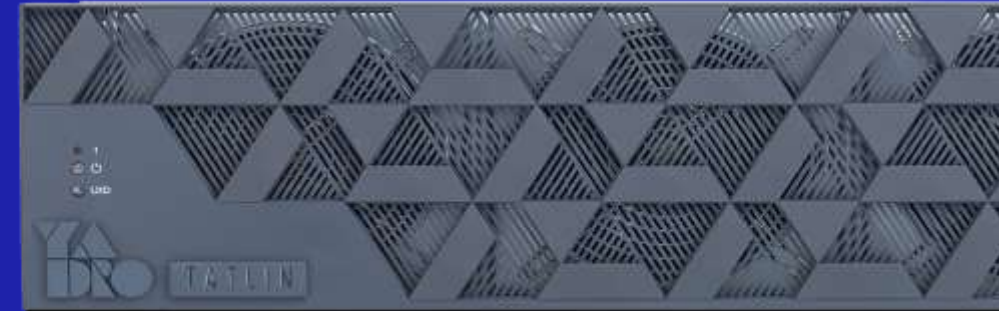
Обработывайте данные молниеносно благодаря высокому уровню производительности и внушительному объему кэш-памяти

Основные параметры

- 2 контроллера хранения (в режиме Symmetric Active-Active)
- Тип подключения к полкам расширения: PCIe 3.0 /SAS 3.0
- Быстрый кластерный интерконнект через 100 Gb/s QSFPs
- 4 высокопроизводительных процессора
- 64 ядра на систему

Подключение к хостам

- Ethernet 10/25 Gb/s SFP28 (20 портов)
- FC 16 Gb/s SFP28 (40 портов)
- FC 32 Gb/s SFP28 (20 портов)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКОВЫХ ПОЛОК

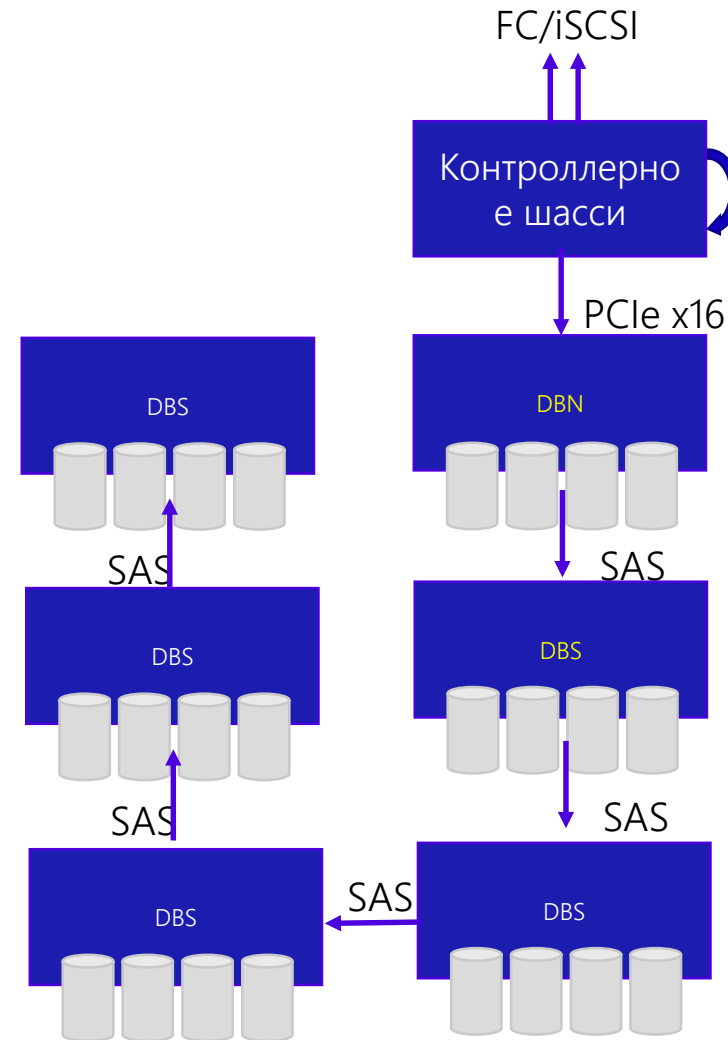


Виды дисковых полок на выбор

- Disk Bay NVMe (DBN): до 34 NVMe и до 70 SAS модулей
- Disk Bay SAS (DBS): до 96 SAS модулей

Высокопроизводительная конфигурация

- Возможность поддержки до 584 накопителей (17 418 ТБ) для самых высоконагруженных приложений и баз данных
- Интерфейсы подключения дисков: SAS 3.0, PCIe 3.0





СЕРВЕРЫ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ



X2-105

X2-205

Модель	X2-105	X2-205
Форм-фактор	1U, стандартный 19-дюймовый шкаф	2U, стандартный 19-дюймовый шкаф
Вычислительная мощность	До 2 × 2nd Gen Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 165 Вт	До 2 × 2nd Gen Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 205 Вт
Память	24 × DDR4-2933/2666/2400/2133, 2DPC. Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM	
Локальное хранение данных	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 4 × LFF SAS/SATA спереди• 10 × SFF (8 × SAS/SATA, 2 × SATA) спереди• 2 × SFF SAS/SATA + 8 × SFF SAS/SATA/ NVMe спереди	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 8 × LFF SAS/SATA + 4 × SFF SAS/SATA/ NVMe спереди• 24 × SFF SAS/SATA спереди• Дополнительно 2 × SFF SAS/SATA сзади
Накопители для загрузки ОС	2 × 2280 M.2 SATA SSD (Software RAID)	
Возможности расширения	<ul style="list-style-type: none">• 1 × PCIe Gen3 x16 FHHL +• 2 × PCIe Gen3 x8 HHHL +• 1 × OCP2.0 TypeA *	<ul style="list-style-type: none">• 2 × PCIe Gen3 x16 + 2x8, либо• 1 × PCIe Gen3 x16 + 4x8, либо• 6 × PCIe Gen3 x8 Ко всем вариантам дополнительно 1 × OCP2.0 TypeA*



KVADRA D20: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Процессоры	Семейство 11/10 поколение Intel® Core™ i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Чипсет	Intel® B560
Поддерживаемые операционные системы	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Windows™ 10 Pro/11 Pro • Astra Linux® 1.7 SE/2.12 CE • ОС «Альт» (8СП, «Рабочая Станция» 9/10, «Образование» 9) • РЕД ОС 7.3
Оперативная память	DDR4 SODIMM до 32 ГБ
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 4 × USB 3.0 • 2 × USB 2.0 • 1 × USB Type-C
Накопители	<ul style="list-style-type: none"> • M.2 NVMe до 1 ТБ • SSD/HDD 2,5" до 1 ТБ
Интерфейсные разъемы	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3.5 мм разъем для наушников • 2 × 3.5 мм разъем для микрофона • 1 × RJ-45 • 1 × HDMI • 1 × DisplayPort • 1 × разъем питания
Кардридер	Три в одном (SD/MS/MMC)
Стандарт крепления	VESA, 100 × 100 мм (опционально)
Wi-Fi	Intel® AC3165 b/g/n/ac M.2
Ethernet	10/100/1000 Мбит/с RJ-45
Bluetooth	4.2



KVADRA A20: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Процессоры	Семейство 11/10 поколение Intel® Core™ i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron (до 65 Вт)
Чипсет	Intel® B560
Дисплей	23,8", разрешение 1920×1080 Full HD
Поддерживаемые операционные системы	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® Windows™ 10 Pro/11 Pro • Astra Linux® 1.7 SE/2.12 CE • ОС «Альт» (8СП, «Рабочая Станция» 9/10, «Образование» 9) • РЕД ОС 7.3
Оперативная память	DDR4 SODIMM до 32 ГБ
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 4 × USB 3.0 • 2 × USB 2.0
Накопители	<ul style="list-style-type: none"> • M.2 NVMe до 1 ТБ • SSD/HDD 2,5" до 1 ТБ • Привод оптических дисков (опционально)
Интерфейсные разъемы	<ul style="list-style-type: none"> • 1 × 3,5 мм сдвоенный разъем для наушников и микрофона • 1 × 3,5 мм разъем для наушников • 1 × 3,5 мм разъем для микрофона • 1 × RJ-45 • 1 × HDMI • 1 × DisplayPort • 1 × разъем питания
Фронтальная камера	5.0 МП, выдвигающаяся
Колонки	2 × 3 Вт стерео
Стандарт крепления	VESA, 100 × 100 мм
Wi-Fi	Intel® AC3165 b/g/n/ac M.2
Ethernet	10/100/1000 Мбит/с RJ-45
Bluetooth	4.2



Где мы это производим ?



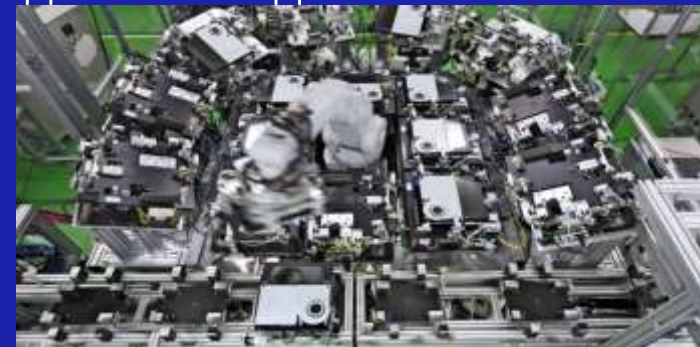
YADRO FAB MALAKHOVKA

На заводе площадью 3500 м² на данный момент производится продукция компании, в год производит 30 000 серверов YADRO VEGMAN, 7 000 систем хранения данных YADRO TATLIN, 200 серверов класса mission critical. Производство включает линию поверхностного монтажа, линию конвейерной сборки, линии тестирования и контроля качества.



YADRO FAB DUBNA (старт апрель 2021)

Производственное предприятие полного цикла площадью 40 000 м², включающее линии производства печатных плат, линии поверхностного монтажа, линии конвейерной сборки, системы тестирования и контроля качества. Плановая дата запуска производства первый квартал 2023 года. Плановый объем производимой продукции до 1 млн изделий в год.





Сравнение программ поддержки.

Услуга	Программа Базовая	Программа Оптимальная	Программа Расширенная
Доступность средств самостоятельной регистрации и управления инцидентами	24x7	24x7	24x7
Режим обслуживания	9x5 ¹	24x7	24x7
Обслуживание в праздничные и выходные дни	-	Да	Да
Целевое время реакции, не более	4 часа ²	2 часа ²	1 час ²
Фиксированное время восстановления ¹⁰	-	Опция ³	Опция ³
Фиксированное время доставки запчасти ¹⁰	Опция ⁴	Опция ⁴	Опция ⁴
4-х часовое прибытие инженера Сервисной Службы на площадку с запчастью ¹⁰	-	Опция ⁵	Опция ⁵
Опция невозврата накопителей	Опция	Опция	Опция
Возможность выезда на площадку для замены запчастей категории CRU	Нет	Опция ⁶	Опция ⁶
Резерв запчастей на складе	Нет	Опция ⁷	Опция ⁷
Анализ корневой причины инцидента ⁸	Нет	Нет	Приоритет 1
Уведомления о выходе новых прошивок (ежеквартально)	Нет	Нет	Да
Установка обновления прошивок силами инженеров YADRO	Нет	Удаленно ⁹	Да
Удаленный мониторинг работоспособности оборудования 24x7	Нет	Да	Да
Профилактические мероприятия	Нет	2 раза в год	4 раза в год
Предоставление отчетов по зарегистрированным инцидентам	Нет	По запросу, не более 2-х раз в год	4 раза в год
Выделенный сервисный менеджер	Нет	Нет	Да





СПАСИБО!

Дмитрий Ерошенко
Региональный
представитель
+7 914 541 20 24
d.eroshenko@yadro.com